



团 体 标 准

T/ZZB 1718—2020

半导体封装用键合金丝

Gold bonding wire for semiconductor package



2020 - 09 - 30 发布

2020 - 10 - 30 实施

浙江省品牌建设联合会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 基本要求	1
4 产品分类和标记	1
5 技术要求	2
6 试验方法	6
7 检验规则	6
8 标志、包装、运输和贮存	6
9 质量证明书	8
10 质量承诺	8

